



**关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
的审核中心意见落实函的回复**

**保荐机构（主承销商）**



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

## 深圳证券交易所：

贵所《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2026〕010043号）（以下简称“问询函”）已收悉。托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“发行人”、“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“保荐人”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“申报会计师”）等相关方对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

### 说明：

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书（申报稿）中的相同。

### 二、本回复报告中的字体代表以下含义：

问询函所列问题	<b>黑体（加粗）</b>
问询函所列问题的回复	宋体
对招股说明书的引用	宋体
对招股说明书的修改、补充	<b>楷体（加粗）</b>

三、本回复报告中若出现总计数尾数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 目 录

目 录 .....	2
1.关于业绩稳定性 .....	3

## 1. 关于业绩稳定性

招股说明书显示：

2025 年，发行人实现营业收入 71,984.64 万元，同比增长 18.00%，收入增速有所下滑；实现扣非后归母净利润 9,353.12 万元，较 2024 年略有减少。发行人称，主要系 2025 年扩产导致整体产能利用率下降，主营业务毛利率同比下滑。

请发行人披露：

(1) 2025 年发行人营业收入增速下滑的原因，与半导体设备行业发展趋势、同行业可比公司业绩变动趋势的差异及原因。

(2) 2025 年发行人营业收入增速放缓，仍持续扩产的主要考虑，并结合本次募投项目新增产能情况，披露是否存在产能消化风险。

(3) 结合在手订单数量、价格及产能利用率预计变动情况，报告期内汇兑损益变化情况，分析发行人毛利率及经营利润是否存在进一步下滑的风险，并完善相关风险提示。

请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。

答复：

一、请发行人披露

(一) 2025 年发行人营业收入增速下滑的原因，与半导体设备行业发展趋势、同行业可比公司业绩变动趋势的差异及原因

1、2023 年下半年以来行业步入复苏周期，发行人营业收入快速增长

2023 年下半年以来行业进入复苏上行周期，2024 年迎来了行业大幅增长，如发行人主要客户中微公司披露其 2024 年刻蚀设备产量同比增长 231.15%。发行人同行业可比公司均实现了相对较高的增长，其中先锋精科 2024 年半导体设备零部件收入增速达 134.64%、珂玛科技半导体领域收入增速达 205.89%、富创精密半导体设备零部件收入增速为 55.59%。

2024 年，发行人在半导体领域的收入增速较同行业平均增速高，略低于先锋精科，较大幅度低于珂玛科技。主要系：1) 富创精密和臻宝科技增速相对较低，富创精密在

2024 年营收规模已突破 30 亿元，较高的基数对其维持同等增速构成了更大挑战；臻宝科技主营业务为半导体非金属零部件，2024 年增速相对较低，主要系 2023 年基数较高，根据其披露信息：“2023 年通过客户 3、客户 4 及客户 1 先进制程厂区验证形成批量销售所致”，臻宝科技 2023 年及 2024 年先进制程半导体零部件收入增速分别为 121.6% 和 25.41%。相比之下，金属零部件领域的发行人与先锋精科的业务基数相对较小，业绩弹性更为显著；2) 珂玛科技 2024 年收入增速最高，其披露主要系“陶瓷加热器实现国产替代，解决了半导体晶圆厂商 CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题，公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。”

## 2、2025 年发行人收入增速下滑分析

经历了 2024 年的高速增长，2025 年，发行人营业收入仍保持增长，但增速有所下滑，主要系下半年受主要客户及终端客户扩产需求放缓及部分订单推迟交付影响。一方面，传统消费电子、汽车及工业需求回升放缓，拉动半导体市场增长的驱动因素主要在 AI 领域需求的先进逻辑、存储及封装等领域，整体国内设备及零部件市场增速有限；另一方面，先进半导体设备出口管制使得国内先进制程产线验证及交付周期拉长。同行业可比公司中与发行人业务及产品相类似的富创精密、先锋精科 2025 年收入增速也出现回落，分别增长 16.81%、8.98%，低于发行人 2025 年收入增长率。

### (1) 半导体设备行业发展情况

2024 年及 2025 年，中国大陆的半导体设备支出达 495.5 亿美元、493 亿美元，同比增速为 35%、-0.5%，反映出晶圆厂资本开支节奏在高增长之后有所放缓。

发行人主要客户北方华创和中微公司作为国内半导体设备行业销售规模前二的企业，则在 2025 年仍呈现出稳定增长趋势。报告期内，发行人两大主要客户北方华创和中微公司的收入及存货增长情况如下：

单位：万元

项目	客户	2025 年 1-9 月/2025 年	2024 年
收入	北方华创	2,730,137.97	2,983,806.92
	同比增速	34.14%	35.14%
	中微公司	1,238,463.83	906,516.51
	同比增速	36.62%	44.73%
存货	北方华创	3,019,889.64	2,363,492.96

	同比增速	30.01%	39.09%
	中微公司	716,997.22	703,851.87
	同比增速	1.87%	65.21%

注：北方华创尚未披露 2025 年年报，采用 2025 年三季报数据。2023 年及 2024 年来源于上市公司北方华创和中微公司年报。

由上表可知，2025 年发行人下游主要客户收入及存货增速有所放缓。

另一方面，从产销量数据来看，具体到发行人主要客户，其中北方华创体量较大且未披露其设备的产销量信息，而根据发行人主要客户中微公司公开信息，其设备以刻蚀设备为主（超过 90%），其报告期内刻蚀设备生产及销售情况、与发行人对中微公司零部件销售收入对比如下：

单位：腔、万元

项目/年度	2025 年	2024 年	2023 年
刻蚀设备（产量）	1,660	1,414	427
产量同比增速	17.40%	231.15%	
刻蚀设备（销量）	1,240	908	606
销量同比增速	36.56%	49.83%	
发行人对中微公司销售的零部件收入（应用于刻蚀设备）	23,686.90	18,513.59	8,281.22
同比增速	27.94%	123.56%	

由上表可知，发行人客户中微公司的产量增长有所放缓，与发行人对其销售收入增长变缓趋势一致。

## （2）与同行业可比公司业绩变动趋势比较

2025 年，发行人营业收入与同行业可比公司较 2024 年变动情况比较如下：

单位：万元

公司名称	2025 年	2024 年	同比增速
富创精密	355,056.39	303,956.79	16.81%
先锋精科	123,772.76	113,577.41	8.98%
珂玛科技	107,000.00	85,738.20	24.80%
臻宝科技	86,758.17	63,450.10	36.73%
发行人	71,984.64	61,005.34	18.00%

注：富创精密为 2025 年业绩快报数据，珂玛科技 2025 年数据用业绩预告的区间中位值。

由上表可知，发行人 2025 年营业收入增速高于富创精密和先锋精科，低于珂玛科技和臻宝科技。

与珂玛科技和臻宝科技虽同属半导体设备零部件行业，但产品及业务具有较大差异，

其中：1) 珂玛科技主要产品为陶瓷零部件及表面处理业务，2025 年收入增长主要系其核心产品“功能-结构”一体模块化产品大规模量产并交付客户以及来自国内外半导体设备厂商的产品销售收入较 2024 年同期继续保持增长；2) 臻宝科技主要产品及服务为非金属零部件和表面处理业务，2025 年收入增长较多主要系单价较高的石英和硅零部件的销量占比提升，前五大客户包括两家主流存储芯片制造厂商，2025 年系存储芯片大年，其对臻宝科技的采购增长明显。

与先锋精科相比，发行人 2025 年营业收入增速高于先锋精科，主要系各类零部件收入增速均更高，其中关键工艺零部件收入增速更高得益于特色产品匀气环的收入大幅增长以及内衬、静电卡盘基体的收入增加。2024 年及 2025 年，发行人与先锋精科分大类产品收入比较情况如下：

单位：万元

分类	发行人			先锋精科		
	2025	2024	变动	2025	2024	变动
半导体关键工艺零部件	35,843.90	30,449.97	17.71%	89,409.33	81,906.26	9.16%
半导体工艺零部件	9,257.32	8,248.58	12.23%			
半导体结构零部件	19,799.92	17,337.22	14.20%	23,784.85	22,663.22	4.95%
激光设备零部件	4,632.04	3,608.89	28.35%			
其他（模组、表面处理业务等）	1,853.60	964.51	92.18%	6,378.94	5,072.49	25.76%
<b>合计</b>	<b>71,386.79</b>	<b>60,609.18</b>	<b>17.78%</b>	<b>119,573.12</b>	<b>109,641.97</b>	<b>9.06%</b>

注：发行人此处为主营业务口径，先锋精科与 2025 年年报略有差异，系按其披露的分产品口径加总计算而得。

富创精密 2025 年营业收入实现增长 16.81%，一方面，随着海外头部晶圆厂资本开支重回扩张周期，相关需求同步增长；另一方面，国内下游客户加速供应链本土化，对国产设备零部件的需求快速提升。发行人 2025 年收入总体规模仍较富创精密有一定差距，但收入增速略高于富创精密。

综上，发行人 2025 年收入增速回落系国内半导体设备及零部件行业 2024 年实现高速增长，2025 年整体持续平稳运行，为先进制程迭代突破蓄力。发行人收入增长变动趋势与同行业可比公司中业务及产品相近的富创精科、先锋精密类似。

**（二）2025 年发行人营业收入增速放缓，仍持续扩产的主要考虑，并结合本次募投项目新增产能情况，披露是否存在产能消化风险。**

### 1、本次募投项目新增产能情况

发行人本次精密零部件智能制造建设项目拟投资额合计 95,616.05 万元，将在现有业务经验的基础上，通过购置新型制造设备并建设智能工厂，实现半导体精密零部件加工中心的制造产能升级和工艺更新，从而提升产品的洁净度及工艺技术水平，确保产品质量的稳定性。本次募投项目的建设在扩充公司产能的基础上，对现有产品进行迭代升级，布局多种前沿制造工艺及复合零部件产品，为客户提供更完善、更优质的精密零部件产品。发行人本次募投项目达产后，预计新增产值约 110,868.78 万元/年，覆盖半导体关键工艺零部件、半导体结构零部件、半导体工艺零部件，并建设系统组装产能及配套建设表面处理服务。

## 2、持续扩产的主要考虑

### (1) 半导体设备行业整体向好，本次募投项目新增产能符合行业发展增长趋势

受益于 5G、AI 及物联网等新兴技术驱动，2019-2022 年开始，全球半导体设备市场开始稳健的扩张周期，自 2019 年的 598 亿美元增至 2022 年的 1,076 亿美元，年复合增长率达 22%。2023 年全球半导体设备市场规模小幅下滑 1.3%，降至 1,063 亿美元。而随着 2024 年受益于 AI 推动的先进制程投资扩张、高带宽内存（HBM）产能军备竞赛以及中国半导体自主化浪潮不断推进，全球半导体设备销售额同比增长 10%，达 1,171 亿美元，创历史次高。根据 SEMI 预测，2025 年受益于人工智能驱动芯片创新需求持续推动产能扩张和先进制程扩产，全球半导体设备销售额将保持良好增长态势，有望于 2025 年增长至 1,330 亿美元。在先进逻辑、存储器及技术迁移的持续推动下，2026 年、2027 年设备销售额有望进一步攀升至 1,450 亿美元、1,560 亿美元，或将实现连续三年增长。从晶圆厂的设备采购节奏来看，根据 SEMI 预计，晶圆厂设备领域（含晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜及掩模版设备）2024 年创 1,040 亿美元纪录后，预计 2025 年增长 11.0% 至 1,157 亿美元，2026、2027 年预计同比增长 9.0% 和 7.3%，分别达 1,261 及 1,352 亿美元。

从国内市场来看，中国境内半导体设备市场规模自 2018 年的 131 亿美元增至 2024 年的 496 亿美元，市场份额占全球市场规模的 42%。未来，该市场将持续受益于国内积极的产能扩张和政府支持等措施。同时，国产晶圆厂商资本开支的扩张将进一步推动半导体设备产业链景气度上行，从而带动半导体设备零部件用量的提升。根据公开信息，国产部分主要晶圆代工厂商的资本开支计划如下：

公司	2026 年资本开支	具体表述
中芯国际	81 亿美元	中芯国际于 2026 年 2 月投资者问答中表示 2026 年资本开支与 2025 年相比大致持平，根据其披露，其在 2025 年度资本性开支约为 81 亿美元
长鑫存储	69 亿美元（482 亿元）	1、根据长鑫科技招股说明书，其存储器晶圆制造量产线技术升级改造募投项目拟支付购置及安装费约 46.66 亿元，DRAM 存储器技术升级项目拟支付设备购置及安装费 174.00 亿元，两项募投项目建设周期约为三年，均预计于 2028 年完成竣工； 2、根据长鑫科技反馈问询回复，其未来三年因拟投资项目资金需求、新增营运资金、借款利息等造成的资金缺口约 408 亿元，亦体现其具备较大规模的扩产计划 3、参考长鑫存储历年资本性支出情况，其 2022 年至 2025 年 1-6 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 354.31 亿元、436.58 亿元、712.30 亿元、241.15 亿元，均处于较高水平，预计伴随当前存储整体上行周期，其扩产规划仍有望维持高景气度
长江存储	30 亿美元	根据武汉市新洲区人民政府报道，长江存储预计于 2026 年建成投产，其项目公司长存三期（武汉）集成电路有限责任公司注册资本为人民币 207.2 亿元，可主要用于长江存储 2026 年的资本性支出
华虹半导体	13-15 亿美元	根据华虹公司投资者关系活动记录，华虹公司九厂预计 2026 年度资本性支出为 13 亿到 15 亿美元
合计	193-195 亿美元	/

注 1：中芯国际、华虹半导体数据来源为其披露的投资者交流会议纪要；

注 2：长鑫存储、长江存储非上市公司，未披露其 2026 年资本性开支计划，其中长鑫存储资本性开支计划以其 2025 年 1-6 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年化后结果列示（人民币：美元汇率=7：1），结合当前存储扩产上行周期，预计其 2026 年仍将维持高景气度扩产；长江存储参考其长存三期（武汉）集成电路有限责任公司注册资本列示，且长存三期（武汉）集成电路有限责任公司预计可在 2026 年建成投产

从长期趋势来看，存储周期叠加 AI 周期的双重驱动力正在推动半导体行业进入一轮持续性较强的扩产周期，而非短期波动。首先，AI 与存储的双重需求驱动扩产成为长期趋势。AI 大模型训练与推理对 HBM 的需求爆发式增长，同时 HBM 的高产能消耗特性导致标准 DRAM 与 NAND 供给出现结构性紧张，叠加 AI 推理对数据中心 SSD 存储容量的持续拉动，使得全球存储市场供需偏紧态势预计持续至 2027-2028 年，中国境内存储厂商亦在此阶段进行持续拓产。与此同时，随着逻辑芯片向先进制程持续演进，AI 性能提升将推动各类边缘 AI 设备的大规模增长，同时基于本土需求考量，中国境内先进制程产能投资也有望持续扩大，即上述结构性需求驱动的产能扩张具有长期性特征。

其次，在扩产趋势下，全球及中国半导体资本开支的持续增长具有较高确定性。根据 SEMI 于 2025 年 10 月、2026 年 4 月发布的《300mm 晶圆厂展望报告》，全球 300mm

晶圆厂设备支出预计 2026 年、2027 年均保持千亿美金以上，至 2028 年可达 1,550 亿美元，在中国境内方面，受益于国家政策支持和本土制造能力强化，2026 至 2028 年间 300mm 半导体设备投资总额将达 940 亿美元，保持全球领先地位。此外，设备端的持续投入叠加国产化率提升，进一步转化为国内半导体设备厂商的订单增长。在上述行业趋势下，设备厂商销售额的提升将直接带动上游精密金属零部件需求同步增长，同时零部件层面的国产化率提升进一步放大了这一增量效应，伴随本轮 AI 需求驱动下全球半导体设备长景气周期，零部件环节有望同时受益于下游设备市场扩张带来的“量的增长”，以及国产化率提升带来的“份额的扩张”，双重驱动下的成长弹性更为显著。

综上，国内主要晶圆厂商 2026 年资本开支持续处于高位，叠加 AI 基础设施建设和存储扩产周期的长期驱动，半导体设备及零部件行业正迎来需求持续上行的确定性趋势。发行人产品的下游应用领域市场空间有望持续扩大，发行人本次募投项目新增产能符合行业发展增长趋势。

## **(2) 设备端国产化率逐步提升，本次募投项目新增产能是满足国产替代需求的必然选择**

中国作为全球最大的半导体设备消费市场，需求持续旺盛，而当前国产化率仍处于较低水平，国内领先设备厂商如北方华创、中微公司在营业收入规模上与国际头部企业相比存在显著差距。随着国家政策支持和产业链自主化进程加速推进，国产化率有望持续提升，这将直接推动相关设备厂商的市场占有率和收入规模实现大幅增长，进而有效带动半导体设备及零部件产业链的整体协同发展，为国内半导体产业的自主可控提供坚实支撑。在刻蚀、薄膜沉积等核心设备领域，发行人作为国内半导体设备金属零部件第一梯队企业，已与国产设备龙头建立深度战略合作关系，在其金属零部件采购份额中位居前列，未来预计半导体设备国产化率的逐步提升、国产设备厂商的业绩增长将持续为公司新增产能消化提供有力的需求支撑。

在刻蚀设备领域，据 Semi 及半导体产业纵横研究报告数据，2024 年国内刻蚀设备国产化率已突破 30%。以中微公司为例，其开发的 CCP 高能等离子体和 ICP 低能等离子体刻蚀两大类、包括二十几种细分刻蚀设备已可以覆盖大多数刻蚀的应用，可以覆盖从 65 纳米到 3 纳米及更先进工艺的众多刻蚀应用。截至 2025 年末，中微公司 CCP 刻蚀设备累计装机量超过 5,000 反应台，连续十年保持大于 30% 的年平均复合增长率，ICP 刻蚀设备在客户端的累计安装数达到 1,800 个反应台，近 9 年年均增长大于 100%；中

微公司刻蚀设备已于 2025 年全年实现营业收入约 98.32 亿元，同比增长约 35.12%。北方华创已形成 ICP、CCP 等类型刻蚀设备的全系列产品布局，2024 年刻蚀设备收入超 80 亿元，且在 2025 年 1-6 月实现刻蚀设备收入超 50 亿元人民币。

发行人凭借在高精度机械加工、真空钎焊、半导体级表面处理及复杂精密零部件工艺整合等领域的全面技术积累，已具备满足前述头部客户 ICP、CCP 两类设备对金属零部件严苛要求的核心能力。发行人本次募投项目拟扩产的关键工艺零部件产品，已在刻蚀设备中得到充分验证，尤其是在多层流道密封、异种材料焊接、纳米级表面洁净度控制以及高耐腐蚀性表面处理等方面，工艺水平已达到国内前列。

在薄膜沉积设备领域，根据 Semi 及半导体产业纵横研究报告数据，2024 年国内薄膜沉积设备综合国产化率已超 25%，部分细分工艺环节国产化率持续提升。以北方华创为例，公司在物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、原子层沉积（ALD）等领域实现全系列布局，2024 年薄膜沉积设备收入首超 100 亿元。发行人凭借在高精度机械加工、真空钎焊、半导体级表面处理及复杂精密零部件工艺整合等领域的全面技术积累，已具备满足 PVD、CVD、ALD 三类薄膜沉积设备对金属零部件严苛要求的核心能力。公司量产的腔体、内衬、匀气盘、加热器、冷盘、静电卡盘基体、气体分布盘等关键工艺零部件，已在薄膜沉积设备中得到充分验证，尤其是在多层流道密封、异种材料焊接、纳米级表面洁净度控制以及高耐腐蚀性阳极氧化等方面，公司工艺水平位居国内前列。

随着刻蚀设备及薄膜沉积设备国产化需求上升与技术的持续突破，公司将依托全流程工艺平台与深度协同研发模式、快速响应客户对下一代设备零部件的定制化需求，为国产半导体设备的产能扩张提供坚实的金属零部件配套支撑，直接受益于半导体设备国产化替代的发展趋势，本次募投项目新增产能是满足国产替代需求的必然选择。

### **3、是否存在产能消化风险**

新增产能消化措施方面，一方面，公司将持续聚焦先进制程领域，加大技术研发投入，充分发挥自身在复杂精密零部件领域的产品优势与工艺优势，与核心客户深度绑定，协同推进设备制程的持续突破，巩固并提升与头部设备厂商的合作关系，以把握中国半导体行业长期增长的结构性的机遇。报告期内，尽管公司整体收入增速有所放缓，但应用于半导体设备领域的先进制程零部件相关收入占比从 2023 年的 8.13% 提升至 2025 年的

23.06%，其中，半导体关键工艺零部件的先进制程相关收入占比从 2023 年的 6.39% 提升至 2025 年的 31.78%；截至 2025 年 12 月 31 日，发行人在手订单中应用于先进制程半导体设备零部件的金额占比为 21.14%，其中半导体关键工艺零部件中先进制程占比为 27.87%，同样维持在较高水平，体现了发行人的产品结构持续向高附加值方向优化，为公司产能消化提供了更高质量的需求支撑。同时，公司将通过优化生产管理、实施精益生产，在保障产品质量稳定性的同时提升成本优势，进一步巩固并扩大在客户供应体系中的份额，为新增产能的顺利消化奠定业务基础。

考虑到公司本次募投项目的产能规划虽经过前期充分的市场分析和论证，具备较强的实施基础，募投项目新增产能过剩或闲置产能无法消化的风险整体较低。但出于审慎性考虑，公司业务可能受宏观经济超预期下行、半导体产业链整体景气度大幅下滑、产业政策或下游需求急剧变化等不可预见因素的影响，在极端情形下新增产能存在无法消化的风险。发行人已在招股说明书中披露如下：

#### “（一）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金将投资于托伦斯精密零部件制造及研发基地项目，并补充流动资金，需要购置较多研发设备、生产设备、测试设备等。报告期各期，公司产能利用率分别为 77.50%、97.57%、83.68%，本次募投项目系发行人提高产能的重要投资项目，如果在项目实施过程中建设进度、投资成本、宏观经济形势、相关产业政策等客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、涉及研发项目实施效果是否符合预期、募投项目产能利用情况等将存在不确定性，从而影响公司业绩，为公司的生产经营和未来发展带来一定的风险。同时，若行业需求出现较大波动，如下游以及终端客户因技术迭代或供应链、产能等因素推迟相应零部件需求、以及发行人募集资金投资项目方向涌入新的竞争者，则存在新增产能消化较慢的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。”

**（三）结合在手订单数量、价格及产能利用率预计变动情况，报告期内汇兑损益变化情况，分析发行人毛利率及经营利润是否存在进一步下滑的风险，并完善相关风险提示。**

#### 1、发行人在手订单数量、价格及产能利用率预计变动情况

##### （1）在手订单情况

截至 2025 年末，公司在手订单数量及单价情况如下：

单位：件、万元/件、万元

产品	截至 2025 年 12 月 31 日的在手订单			2025 年
	数量	单价	金额	销售均价
半导体关键工艺零部件	7,400	1.67	12,392.38	1.26
加热器	205	2.61	534.57	2.32
静电卡盘基体	684	3.06	2,090.07	2.56
冷盘	200	3.32	664.13	3.49
内衬	2,383	0.82	1,962.14	0.74
气体分布盘	452	1.17	529.96	1.27
腔体	1,240	1.65	2,047.29	1.37
退火设备灯罩	14	23.01	322.12	23.01
匀气环	1,891	2.02	3,829.23	1.60
匀气盘	331	1.25	412.88	1.30
半导体工艺零部件	3,987	0.66	2,612.35	0.58
半导体结构零部件	119,116	0.04	4,990.00	0.04
激光设备零部件	19,470	0.03	559.82	0.07
其他	20,593	/	312.33	/
合计	170,566	0.12	20,866.87	0.07

注：其他含表处服务，不适用单价比较。

报告期内，公司在手订单规模稳步增长，订单平均单价有所提升。2025 年末公司在手订单中，半导体关键工艺零部件、半导体工艺零部件、半导体结构零部件订单单价均高于 2025 年上述三类分类平均销售单价。

发行人主要大客户基于自身库存管理与生产计划安排，通常按季度滚动下达短期订单，发行人期末在手订单仅反映未来短期待执行规模，无法完整体现年度实际业务体量。从订单执行特征来看，主要客户订单下单频率较高，平均下单间隔短，订单滚动更新快、执行连续性强，业务合作具有良好的稳定性与可持续性。

报告期内，前五大客户在自然年度内下单的日期及下单频率统计如下：

单位：天

客户名称	2025 年下单天数	2024 年下单天数	2023 年下单天数	2025 平均间隔 (天)	2024 平均间隔 (天)	2023 平均间隔 (天)	全周期平均间隔 (天)

客户名称	2025 年下 单天数	2024 年下 单天数	2023 年下 单天数	2025 平均 间隔 (天)	2024 平均 间隔 (天)	2023 平均 间隔 (天)	全周期平 均间隔 (天)
北方华创	268	267	231	1.34	1.35	1.56	1.41
中微公司	261	235	202	1.38	1.53	1.78	1.55
Lumentum	46	55	80	7.83	6.55	4.50	5.97
宸微科技	238	157	65	1.51	2.29	5.54	2.35
无锡尚积	126	99	27	2.86	3.64	13.33	4.29
稷以科技	64	84	70	5.63	4.29	5.14	4.95
博智航	14	40	63	25.71	9.00	5.71	9.23
科迪亚 (注)	-	-	17	-	-	21.18	63.53

注：科迪亚 2024 年后不再合作，主要系终端客户调整下单渠道商。

## (2) 产能利用率情况

报告期内，发行人产能利用率分别为 77.50%、97.57%、83.68%，2025 年产能利用率下滑主要系下半年发行人投资较多新设备，下游客户需求及订单交付在下半年特别三季度有所放缓。2026 年，发行人产能预计同比增长超过 10%。2026 年一季度，发行人产能利用率约 73.22%，主要系发行人 2025 年下半年投产产能尚未完全释放以及春节假期影响，但较 2025 年四季度产能利用率有所回升。另一方面，截至 2026 年 3 月末，发行人在手订单为 23,887.98 万元，较 2025 年末增长约 15%。

2026 年，中国境内存储芯片及先进制程逻辑芯片的扩产趋势仍将延续，国内长江存储、中芯国际、华虹半导体等头部厂商持续扩产，叠加 AI 芯片需求驱动的先进逻辑产能扩张，预计 2026-2028 年间中国大陆 300mm 芯片制造厂设备支出总额将达 940 亿美元。上述扩产趋势同样传导至半导体设备企业，以发行人主要客户北方华创为例，其于 2025 年三季度报告中披露在手订单规模大幅增加；中微公司亦于 2025 年年度报告中披露其截至 2025 年年末合同负债达 30.44 亿元，同比增长 17.68%，为发行人创造了良好的外部增长环境。随着发行人不断研发新品、客户开拓初见成效，2026 年全年预计产能利用率将较 2025 年稳中有升。

## 2、报告期内汇兑损益的变化情况

报告期内，发行人汇兑损益的变化情况如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
汇兑损益金额 (万元, 收益为正 / 损失为负)	-658.56	190.93	-44.27
汇兑损益占营业利润比例	-5.98%	1.59%	-2.80%

报告期内汇兑损益对利润的影响逐步扩大，主要系报告期内发行人外销收入持续增长，美金货币资金规模相应增加所致。

报告期内，影响发行人汇兑损益的构成如下：

单位：万元

影响构成	2025年	2024年	2023年
货币资金	-605.70	167.27	-54.78
应收账款	-52.77	27.10	11.00
应付账款	-0.09	0.15	-0.70
其他应收	-	-0.14	0.21
交易性金融资产	-	-3.45	-
<b>总计</b>	<b>-658.56</b>	<b>190.93</b>	<b>-44.27</b>

截至 2025 年末，发行人外币余额如下：

单位：美元，万元

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	4,310.74	7.0288	30,299.34
应收账款	-	-	-
其中：美元	345.47	7.0288	2,428.23

以 2025 年末汇率为基础，

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，公司将减少或增加净利润 278.18 万元；

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 3%，公司将减少或增加净利润 834.55 万元；

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，公司将减少或增加净利润 1,390.92 万元。

报告期各期末，美元兑人民币汇率中间价情况及同比变动如下：

期末时点	汇率	同比变动
2023-12-29	7.0827	1.70%
2024-12-31	7.1884	1.49%
2025-12-31	7.0288	-2.22%

因此，按前述测算，若人民币到 2026 年末兑美元进一步温和升值，如 1%，即汇率

6.95，则对 2026 全年净利润影响 278.18 万元，若进一步大幅升值 3%至 6.81，则对 2026 全年净利润影响 834.55 万元，整体影响预计占发行人全年利润比例仍处于较低水平。

针对外汇风险，发行人拟采取的措施：

(1) 中微公司自身不同主体不同项目采取不同的采购计划，但总体由于金桥保税区产能有限，中微公司临港研发及生产基地、南昌基地在逐渐发展壮大，发行人正积极沟通后续新品号的采购采取非保税区的其他人民币结算主体进行；

(2) 发行人将密切关注汇率走势，加快结汇及采用套期保值产品，降低汇率风险。

发行人已在招股说明书之“第三节 风险因素”之“三、其他风险”之“(二) 汇率波动风险”更新披露如下：

“报告期内，公司主营业务收入中销售至保税区及其他境外地区的境外收入占比分别为 31.42%、16.82%、23.61%，且主要以美元结算。报告期内公司汇兑损益分别为 44.27 万元、-190.93 万元、658.56 万元（负数表示收益）。未来若人民币与美元汇率因境内外环境、政治形势、货币政策等影响发生大幅波动，以及未来公司经营规模持续扩大后，同时公司以美元结算的交易及留存的外币资金进一步增长，可能使得公司面临汇兑损失风险，进而对公司未来的净利润造成一定的不利影响。”

### 3、发行人毛利率及经营利润是否存在进一步下滑的风险

综合在手订单、价格、产能利用率及汇率影响，公司毛利率与经营利润存在一定波动风险，但持续大幅下滑风险较小，具体分析如下：

(1) 发行人在手订单充足，在手订单单价稳中有升，支撑盈利能力的稳定性；发行人致力于持续根据订单结构与市场需求优化生产排程，通过多种方式维持产能利用率稳定，保障毛利率稳定；

(2) 公司管理团队、研发团队及销售团队已逐步搭建完成，内部管理体系日趋规范、运营流程持续完善。随着营业收入稳步增长，规模效应将逐步体现，公司经营利润有望实现持续提升；

(3) 针对汇兑损益的影响，公司已采取积极有效的策略，积极开拓新客户，优化结算方式，降低汇率波动对整体业绩的影响。

发行人已在招股说明书中“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、毛利率下滑的风险”以及“第三节 风险因素”之“（三）财务风险”之“1、毛利率下滑的风险”补充披露，具体如下：

### “2、毛利率下滑的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 23.26%、29.89%、27.14%。随着 2023 年下半年以来半导体设备及零部件行业高速增长，公司销售及产能规模也大幅增加，2025 年下半年起行业高速增长有所放缓，公司整体毛利率小幅下降。

未来，若下游客户及终端客户投资意愿减弱或推迟，或因出口管制、技术迭代突破等各种原因需求增长放缓，且公司未能加大市场开拓力度以获取更多订单，及时推出满足先进制程需求的新产品，则可能面临收入增速放缓、毛利率进一步下滑的情形，从而对公司经营业绩产生不利影响。”

同时，发行人已在招股说明书中“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、经营业绩持续性风险”如下：

### “3、经营业绩持续性风险

报告期内，公司产品主要应用于半导体领域，产品销售与下游半导体行业景气度相关。自 2023 年下半年以来，在国内半导体设备国产化进程加速、半导体制造厂商扩产的共同驱动下，半导体零部件行业进入显著上行周期，公司营业收入伴随行业景气度同步实现稳健增长。最近三年，公司营业收入年化增长率为 57.39%，公司归母净利润年化增长率为 153.27%，但公司 2025 年归母净利润同比有所减少。

然而，若未来国家产业政策发生调整，或半导体行业发展不及预期导致行业景气度下降，下游半导体制造客户的投产或产线更新意愿将可能减弱，从而引致半导体设备销售量减少，对公司经营业绩造成不利影响，导致公司业绩增速放缓甚至出现下滑。此外，公司本次募投项目虽有望带来收入增长，但在项目达产前，因新增折旧摊销与期间费用，公司可能面临净利润增速低于营业收入增速的情况，致使公司业绩在短期内承受增速放缓甚至下行的压力。”

## 二、核查程序及核查意见

### （一）核查程序

发行人保荐机构执行了以下核查程序：

1、查阅 SEMI、QY Research 等权威机构发布的半导体设备市场规模、国产化率数据，复核发行人市场空间测算逻辑及数据来源；

2、获取并查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告、募投项目经济效益测算表，了解本次募投项目支出的具体内容、新增产能的具体情况；

3、查阅下游行业的研究报告、了解下游应用领域的市场空间情况、主要厂商的资本开支计划，分析本次募投项目的合理性与必要性及产能消化风险；

4、查阅同行业可比公司及下游主要客户的年度报告或季报，分析发行人 2025 年营业收入下滑的原因及与可比公司的差异；

5、获取发行人在手订单，分析在手订单价格变动，了解发行人产能增长情况；

6、分析发行人报告期汇兑损益的变化及原因，以及对发行人业绩的影响。

### （二）核查意见


经核查，发行人保荐机构认为：

1、发行人 2025 年收入增速回落系国内半导体设备及零部件行业短期增速放缓影响，发行人收入增长变动趋势与下游客户采购及生产计划变动相关，与同行业可比公司中业务及产品相近的富创精科、先锋精密类似；

2、发行人拟增产能对应产品具备较为广阔的市场空间，基于当前的行业发展趋势，发行人对现有产能进行扩建具有合理性和必要性，产能无法消化的风险整体较小，且发行人已在招股说明书中披露了相关风险；

3、针对发行人毛利率及经营利润下滑，发行人已在招股说明书中披露了毛利率下滑相关风险及经营业绩持续性风险。

(本页无正文，为托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司《关于托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

法定代表人(签字):   
钱 珂


托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司  
2026年4月16日



## 发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，确认本次审核中心意见落实函回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人：

  
钱 珂

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司



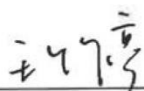
2026年4月16日

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人：



王 帅



王竹亭



## 保荐人法定代表人声明

本人已认真阅读托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核中心意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人：



陈 亮



(本页无正文,为立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》之会计师签章页。根据《关于托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复》中对会计师核查事项的要求,我们仅对问询函中需要会计师进行核查的事项进行回复)。



中国注册会计师:

朱海平



中国注册会计师:

张冀申



中国注册会计师:

吴金婉



中国·上海

二〇二六年四月十六日